

ニュースガイドNo, 10875

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成25年(1年間) 67点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,000-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,000-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥31,500-	¥30,000-

既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10817	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.24	69点	¥20,000
No,10702	"	"	平.23	69点	¥20,000
No,10567	"	"	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	"	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点	¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点	¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点	¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点	¥26,600
No,10830	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.24	70点	¥20,000
No,10700	"	"	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程

No.10875

[登録・公開編] 平成25年(1年間) 67点

CD-ROM版 ¥21,000 B5製本版 ¥21,000 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥31,500)

- | | | | | | |
|----|---|--|----|---|--|
| 1 | 電子部品用金属材料、それをういたコネクタ端子、コネクタ及び電子部品 | JX日鉱日石金属株式会社 | 27 | バンプ形成用非シアン系電解金めっき浴及びバンプ形成方法 | メタローテクノロジーズジャパン株式会社 |
| 2 | 低遊離シアン金塩の製造方法 | 小島化学薬品株式会社 | 28 | 銀めっき材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 |
| 3 | 銀めっき付き繊維材料 | 名古屋メッキ工業株式会社 | 29 | Au, Ag及びCuリサイクルスラッジの製造方法 | 株式会社高松メッキ |
| 4 | バックグラウンドめっきの抑制 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 30 | めっき製品及びめっき方法 | 兵庫県 |
| 5 | パラジウム合金めっき液およびめっき方法 | 松田産業株式会社 | 31 | イミダゾール環結合型オキシアルキレン化合物及び当該化合物を含有するメッキ浴 | 石原薬品株式会社 |
| 6 | めっき部材 | 株式会社大和化成研究所 | 32 | 高温耐性銀コート基体 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 7 | 金めっき層を有するステンレス基板とステンレス基板への部分金めっきパターンの形成方法 | 大日本印刷株式会社 | 33 | 硬質金めっき液 | 小島化学薬品株式会社 |
| 8 | 電子工学の製造分野での錫 - 銀ハンダ・バンプ | エンソン インコーポレイテッド | 34 | 銀めっき材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式会社 |
| 9 | 銀めっき材の製造方法 | 国立大学法人 熊本大学 | 35 | はんだ接続用通電部材、配線用基板及びめっき皮膜の形成方法 | 凸版印刷株式会社 |
| 10 | 電気接点の製造方法 | アルプス電気株式会社 | 36 | 電子部品用金属材料及びその製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 11 | バックグラウンドめっきを抑制する方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 37 | 局在型表面プラズモン共鳴センサーユニット及びその製造方法 | 新日鉄住金化学株式会社 |
| 12 | 銀めっき方法 | 株式会社大和化成研究所 | 38 | 電子部品用金属材料及びその製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 13 | 電解金めっき液及びそれを用いて得られた金皮膜 | 日本高純度化学株式会社 | 39 | 高い表面Al濃度を有するPt含有 - Ni ⁺ - Ni ₃ Al耐酸化コーティング皮膜が付いたNi基基... | 株式会社IHI |
| 14 | 電子部品用金属材料及びその製造方法、それをういたコネクタ端子、コネクタ及び電子部品 | JX日鉱日石金属株式会社 | 40 | PtおよびAl拡散Ni基基材ならびにその製造方法 | 株式会社IHI |
| 15 | 不導性基質へ金属被覆を施す方法 | アトテック・ドイチュラント・ゲーエムベーハー | 41 | 電気化学的に堆積されたインジウム複合体 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 16 | 11(IB)族 - 13(IIIA)族 - 16(VIA)族の元素の、2成分、3成分、4成分もしくは5成... | アトテック・ドイチュラント・ゲーエムベーハー | 42 | 金めっき層を有するステンレス基板 | 大日本印刷株式会社 |
| 17 | 金属めっき処理方法 | トヨタ自動車株式会社 | 43 | 燃料電池用セパレータの製造方法 | 本田技研工業株式会社 |
| 18 | 電子部品用金属材料及びその製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 | 44 | 電解硬質金めっき液、めっき方法、及び、金 - 鉄合金被膜の製造方法 | マテックス・ジャパン株式会社 |
| 19 | めっき方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 45 | 銀変色を妨げる方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 20 | 電解合金めっき液及びそれを用いるめっき方法 | 関東化学株式会社 | 46 | 銀めっき材 | DOWAメタルテック株式会社 |
| 21 | めっき付き銅条材及びその製造方法 | 三菱伸銅株式会社 | 47 | 電子部品用金属材料及びその製造方法 | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 22 | 酸性金合金めっき液 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 48 | Pd電解質浴およびPd - Ni電解質浴 | ユミコア ガルヴァノテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベ シュレンクテル ハフツング |
| 23 | パラジウム - コバルト合金めっき液、パラジウム - コバルト合金被膜の形成方法及びパラジウム - コバルト... | 株式会社サンユー | 49 | パラジウム被覆銅ボンディングワイヤの製造方法 | 日鉄住金マイクロメタル株式会社 |
| 24 | ステンレス基板への金めっき層の形成方法およびそれに用いるめっき装置 | 大日本印刷株式会社 | 50 | インジウム - 銀 - コバルト合金めっき液 | JX日鉱日石金属株式会社 |
| 25 | Fe Pt合金めっき方法およびFe Pt合金めっき液 | 国立大学法人信州大学 | 51 | 金属材料のめっき方法および固体高分子電解質膜・触媒金属複合電極 | 三菱電機株式会社 |
| 26 | 燃料電池に使用される電極を製造するためのプロセス | アトテック・ドイチュラント・ゲーエムベーハー | 52 | めっき浴および方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |

以下15点省略